

適用規格					
定格	使用温度範囲	-55℃～ + 125℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃ (注2)	
	電圧	AC 50 V			
	電流	0.3 A			
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃, 湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -65→ 125℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 (槽の移し換え時間は2~3分)	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150~180℃ 90~120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田 (リペア) の場合 】 半田ごてで 350℃, 3秒の条件にて半田付けを行 う。但し、端子に力を加えないこと。	外觀の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25ppm, 40℃, RH75%に96時間放置する。 (試験規格 : JEIDA-38)	①接触抵抗 : 50 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—
備考					
(注1)通電時の温度上昇を含みます。					
(注2)保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は 使用温度範囲が適用されます。					
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用しています。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	0				
			承認	WR. FUKUCHI	20200716
			検図	TS. MIYAZAKI	20200716
			担当	KT. KUSAKA	20200716
			製図	RN. IIDA	20200715
注	QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目	図番	SLC-389245-51-01		
HRS	製品規格表		製品名	DF12NB (3. 0) -20DS-0. 5V (51)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL537-0099-0-51	△ 1/1